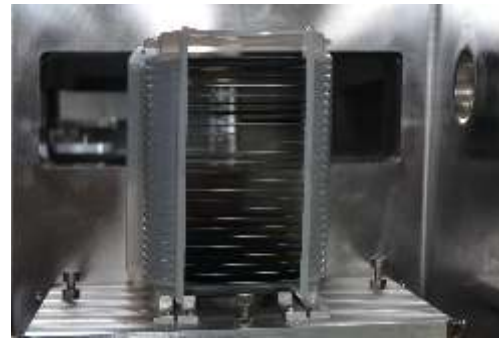


ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА РЕАКТИВНО-ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ КАССЕТЫ В КАССЕТУ

ПЛАЗМА ТМ 8

Назначение: Реактивно-ионное травление алюминиевой металлизации в хлорсодержащей плазме, а также тонких металлических слоев, диэлектрических слоев, кремниевых слоев, материалов группы АЗВ5.



Особенности:

- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек \varnothing 76, 100, 150 мм из кассеты в кассету;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000В;
- Рабочие газы: Cl, BCl_3 , He и др.;
- Скорость травления Al 3000 – 5000 Å в минуту;
- Мощность потребления не более 12 кВт;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ электрода-подложкодержателя в диапазоне 50-400 Вт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

